

2019-2025年中国半导体材料行业市场全景调研及 投资战略研究报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2019-2025年中国半导体材料行业市场全景调研及投资战略研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/detail/456779.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

半导体材料是指电导率介于金属与绝缘体之间的材料，半导体材料的电导率在欧/厘米之间，一般情况下电导率随温度的升高而增大。半导体材料是制作晶体管、集成电路、电力电子器件、光电子器件的重要材料。

半导体材料市场可以分为晶圆材料和封装材料市场。其中，晶圆材料主要有硅片、光掩膜、光刻胶、光刻胶辅助设备、湿制程、溅射靶、抛光液、其他材料。封装材料主要有层压基板、引线框架、焊线、模压化合物、底部填充料、液体密封剂、粘晶材料、锡球、晶圆级封装介质、热接口材料。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 半导体材料行业基本概述

1.1 半导体材料的定义及分类

1.1.1 半导体材料的定义

1.1.2 半导体材料的分类

1.1.3 三代半导体材料简析

1.2 半导体材料的特性

1.2.1 电阻率

1.2.2 能带

1.2.3 满带电子不导电

1.2.4 直接带隙和间接带隙

1.3 半导体材料的制备和应用

1.3.1 半导体材料的制备

1.3.2 半导体材料的应用

1.4 半导体材料的发展历程和产业链介绍

1.4.1 半导体材料发展历程

1.4.2 半导体材料产业链

第二章 2017-2018年全球半导体材料行业发展分析

2.1 2017-2018年全球半导体材料发展状况

2.1.1 市场销售规模

2.1.2 市场结构分析

2.1.3 市场竞争状况

2.2 主要国家和地区半导体材料发展动态

2.2.1 美国

2.2.2 日本

2.2.3 欧洲

2.2.4 韩国

2.2.5 中国台湾

第三章 中国半导体材料行业发展环境分析

3.1 经济环境

3.1.1 宏观经济概况

3.1.2 对外经济分析

3.1.3 工业运行情况

3.1.4 固定资产投资

3.1.5 宏观经济展望

3.2 政策环境

3.2.1 政策驱动行业发展

3.2.2 产业支持政策汇总

3.2.3 第三代半导体材料相关政策

3.3 技术环境

3.3.1 半导体关键材料生产技术突破

3.3.2 第三代半导体材料技术进展

3.3.3 前沿半导体技术研发突破

3.4 产业环境

3.4.1 全球半导体产业规模分析

3.4.2 中国半导体产业规模分析

3.4.3 中国半导体产业分布情况

3.4.4 中国半导体市场发展机会

第四章 2017-2018年中国半导体材料行业发展分析

4.1 2017-2018年中国半导体材料行业运行状况

4.1.1 行业发展特性

4.1.2 行业发展规模

- 4.1.3 产业转型升级
- 4.1.4 市场格局分析
- 4.1.5 应用环节分析
- 4.1.6 项目投建动态
- 4.2 2017-2018年半导体材料国产化替代分析
 - 4.2.1 国产化替代的必要性
 - 4.2.2 国产化替代突破发展
 - 4.2.3 国产化替代的前景
- 4.3 中国半导体材料市场竞争结构分析
 - 4.3.1 现有企业间竞争
 - 4.3.2 潜在进入者分析
 - 4.3.3 替代产品威胁
 - 4.3.4 供应商议价能力
 - 4.3.5 需求客户议价能力
- 4.4 半导体材料行业存在的问题及发展对策
 - 4.4.1 行业发展滞后
 - 4.4.2 产品同质化问题
 - 4.4.3 供应链不完善
 - 4.4.4 行业发展建议
 - 4.4.5 行业发展思路

第五章 2017-2018年半导体硅材料行业发展分析

- 5.1 半导体硅材料行业发展概况
 - 5.1.1 发展现状分析
 - 5.1.2 行业利好形势
 - 5.1.3 行业发展建议
- 5.2 多晶硅料
 - 5.2.1 主流生产工艺
 - 5.2.2 产业发展形势
 - 5.2.3 产量产能规模
 - 5.2.4 区域分布情况
 - 5.2.5 市场价格走势
 - 5.2.6 市场进入门槛
- 5.3 硅片
 - 5.3.1 硅片基本简介

5.3.2 硅片生产工艺

5.3.3 产业发展现状

5.3.4 市场竞争状况

5.3.5 市场价格走势

5.3.6 市场需求预测

5.4 靶材

5.4.1 靶材基本简介

5.4.2 靶材生产工艺

5.4.3 市场发展规模

5.4.4 全球市场格局

5.4.5 国内市场格局

5.4.6 技术发展趋势

5.5 光刻胶

5.5.1 光刻胶基本简介

5.5.2 光刻胶工艺流程

5.5.3 行业运行情况

5.5.4 全球产业格局

5.5.5 国内产业格局

第六章 2017-2018年第二代半导体材料产业发展分析

6.1 第二代半导体材料概述

6.1.1 第二代半导体材料应用分析

6.1.2 第二代半导体材料市场需求

6.1.3 第二代半导体材料发展前景

6.2 2017-2018年砷化镓材料发展状况

6.2.1 砷化镓材料概述

6.2.2 砷化镓物理特性

6.2.3 砷化镓材料应用

6.2.4 砷化镓制备工艺

6.2.5 全球砷化镓规模

6.2.6 国内外竞争格局

6.2.7 砷化镓光电子市场

6.3 2017-2018年磷化铟材料行业分析

6.3.1 磷化铟材料概述

6.3.2 磷化铟市场综述

6.3.3 磷化铟市场潜力

6.3.4 磷化铟市场竞争

6.3.5 磷化铟光子集成电路

第七章 2017-2018年第三代半导体材料产业发展分析

7.1 2017-2018年中国第三代半导体材料产业运行情况

7.1.1 产业发展形势

7.1.2 发展规模分析

7.1.3 区域分布情况

7.1.4 基地建设情况

7.1.5 重点研发项目

7.2 III族氮化物第三代半导体材料发展分析

7.2.1 相关介绍

7.2.2 全球发展状况

7.2.3 国内发展状况

7.2.4 发展重点及建议

7.3 碳化硅材料行业分析

7.3.1 行业发展历程

7.3.2 行业发展优势

7.3.3 主要应用领域

7.3.4 行业发展前景

7.4 氮化镓材料行业分析

7.4.1 氮化镓性能优势

7.4.2 产业发展历程

7.4.3 市场发展机遇

7.4.4 材料发展前景

7.5 中国第三代半导体材料产业投资分析

7.5.1 产业投资价值

7.5.2 项目投建动态

7.5.3 投资时机分析

7.5.4 投资风险分析

7.6 未来第三代半导体材料发展前景展望

7.6.1 产业整体发展趋势

7.6.2 未来应用趋势分析

7.6.3 材料体系更加丰富

第八章 2017-2018年半导体材料相关产业发展分析

8.1 集成电路行业

8.1.1 全球市场规模

8.1.2 国内市场态势

8.1.3 国内销售规模

8.1.4 对外贸易情况

8.1.5 技术进展情况

8.1.6 产业投资状况

8.1.7 产业发展问题

8.1.8 产业发展对策

8.1.9 行业发展目标

8.2 半导体照明行业

8.2.1 全球发展规模

8.2.2 行业发展历程

8.2.3 发展驱动因素

8.2.4 行业政策支持

8.2.5 产业发展规模

8.2.6 对外贸易情况

8.2.7 行业发展展望

8.3 太阳能光伏产业

8.3.1 产业发展规模

8.3.2 技术发展现状

8.3.3 生产规模分析

8.3.4 行业发展态势

8.3.5 产业现存问题

8.3.6 行业发展建议

8.4 半导体分立器行业

8.4.1 技术发展概述

8.4.2 行业发展现状

8.4.3 行业产销规模

8.4.4 行业需求空间

8.4.5 行业出口情况

8.4.6 行业发展趋势

第九章 2017-2018年中国半导体材料行业重点企业经营状况分析

9.1 中国半导体材料行业上市公司运行状况分析

9.1.1 中国半导体材料行业上市公司规模

9.1.2 中国半导体材料行业上市公司分布

9.2 中国半导体材料行业财务状况分析

9.2.1 经营状况分析

9.2.2 盈利能力分析

9.2.3 营运能力分析

9.2.4 成长能力分析

9.3 天津中环半导体股份有限公司

9.3.1 企业发展概况

9.3.2 经营效益分析

9.3.3 业务经营分析

9.3.4 财务状况分析

9.3.5 核心竞争力分析

9.3.6 未来前景展望

9.4 有研新材料股份有限公司

9.4.1 企业发展概况

9.4.2 经营效益分析

9.4.3 业务经营分析

9.4.4 财务状况分析

9.4.5 核心竞争力分析

9.4.6 公司发展战略

9.4.7 未来前景展望

9.5 北方华创科技集团股份有限公司

9.5.1 企业发展概况

9.5.2 经营效益分析

9.5.3 业务经营分析

9.5.4 财务状况分析

9.5.5 核心竞争力分析

9.5.6 公司发展战略

9.5.7 未来前景展望

9.6 宁波康强电子股份有限公司

9.6.1 企业发展概况

9.6.2 经营效益分析

9.6.3 业务经营分析

9.6.4 财务状况分析

9.6.5 核心竞争力分析

9.6.6 公司发展战略

9.6.7 未来前景展望

9.7 上海新阳半导体材料股份有限公司

9.7.1 企业发展概况

9.7.2 经营效益分析

9.7.3 业务经营分析

9.7.4 财务状况分析

9.7.5 未来前景展望

第十章 中国半导体材料行业投资项目案例深度解析

10.1 恒坤股份半导体材料TEOS气体项目

10.1.1 项目基本情况

10.1.2 项目投资价值

10.1.3 项目投资概算

10.1.4 项目资金来源

10.1.5 项目投资风险

10.2 中环股份集成电路用半导体硅片之生产线项目

10.2.1 项目投资背景

10.2.2 项目基本情况

10.2.3 项目投资目的

10.2.4 项目投资价值

10.2.5 项目影响分析

10.3 协鑫集成大尺寸再生晶圆半导体项目

10.3.1 项目投资背景

10.3.2 项目基本情况

10.3.3 项目投资价值

10.3.4 项目投资概算

10.3.5 项目经济效益

10.3.6 项目影响分析

第十一章 中国半导体材料行业前景与趋势预测

11.1 中国半导体材料行业前景展望

- 11.1.1 行业发展趋势
- 11.1.2 行业需求分析
- 11.1.3 行业前景分析
- 11.2 2019-2025年中国半导体材料行业预测分析（AK CY）
- 11.2.1 2019-2025年中国半导体材料行业影响因素分析
- 11.2.2 2019-2025年中国半导体材料市场销售额预测

图表目录：

图表 半导体材料发展“时间简史”

图表 半导体材料产业链

图表 2016-2018年全球半导体材料销售额及增长情况

图表 SiC电子电力产业的全球分布特点

图表 日本主要的半导体材料企业

图表 2016-2018年全球各地区半导体材料消费市场规模

图表 台湾地区半导体材料产业结构

图表 2014-2018年国内生产总值及其增长速度

图表 2014-2018年三次产业增加值占国内生产总值比重

图表 2014-2018年货物进出口总额

图表 2018年货物进出口总额及其增长速度

图表 2018年规模以上工业增加值至同比增长速度

图表 2018年按领域分固定资产投资（不含农户）及其占比

更多图表见正文……

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/456779.html>